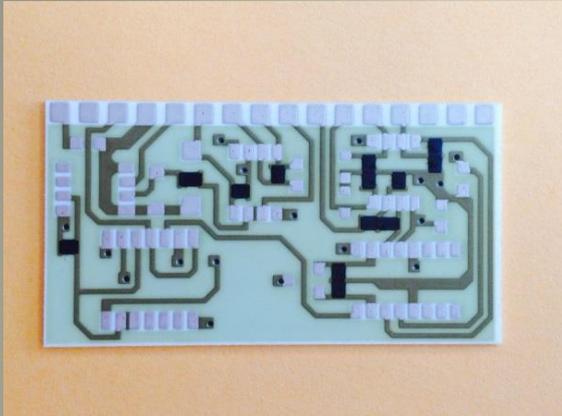


# Ceramic Base Circuit Board

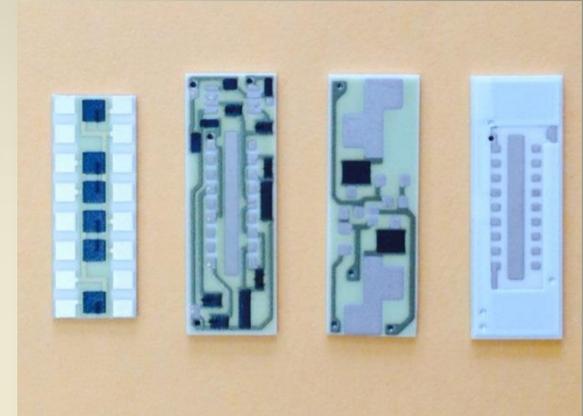
## Thick film printing



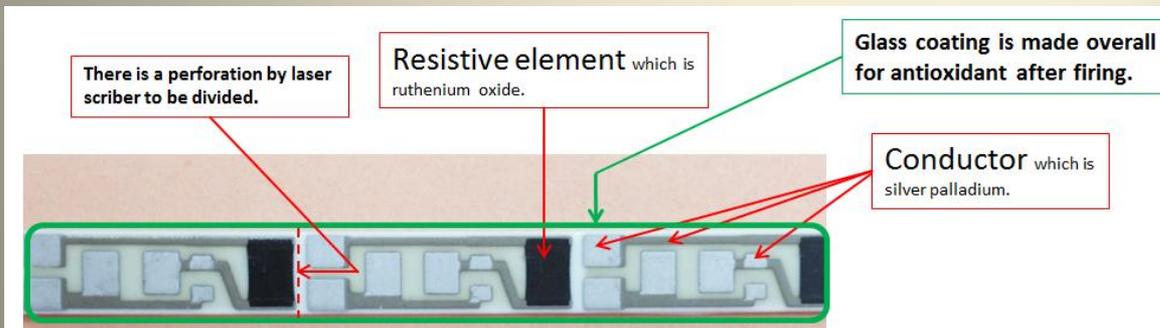
**Hybrid IC circuit board**

### アドバンテージ:

1. 高放熱
2. 高耐熱
3. 大電流対応
4. 耐溶剤性
5. 耐摩耗性
6. 耐電圧
7. 安定した誘電率



**Hybrid IC, capacitor/diode**



**LED module**

### 用途:

- |                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 1. 電車          | 11. パワーモジュール基板<br>(車載、電鉄用、大電力半導体) |
| 2. UPS         | 12. 高周波回路基板                       |
| 3. モーター制御      | 13. 光ピックアップ用サブマウント(DVD, CD用)      |
| 4. MOSFETモジュール | 14. 各種放熱基板                        |
| 5. エアコン        |                                   |
| 6. 冷蔵庫         |                                   |
| 7. インバーター      |                                   |
| 8. トランジスタモジュール |                                   |
| 9. LEDモジュール    |                                   |
| 10. 化学機器用電源    |                                   |



# Ceramic Base Circuit Board

## Thick film printing

### 厚膜セラミクス回路基板、基本仕様

材料	アルミナ96% (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
標準基板サイズ	63mm X 75mm
標準板厚	0.635mm、0.8mm
板厚公差	±10%
反り公差	Max 0.23mm (長手方向 75mm)
最小スルーホール径	Φ0.4mm
スルーホール間の距離	板厚以上
スルーホールから基板端までの距離	板厚以上
導体膜厚(標準)	8~10μm
導体膜厚(max)	厚塗→約12μm、2回塗→約20μm 線幅→0.3mm、線間→0.4mm (膜厚を厚くすると、線幅・線間が多少太くなる)
導体幅寸法/ピッチ(センター・センター)	最小0.2mm/0.4mm
導体から基板端までの距離	≥0.2mm
スルーホールランドサイズ	φ0.8mm (スルーホールφ0.4に対して)
対応基板構造	単層 スルーホール (ホール内導体材料 → 銀パラジウム)
導体材料	銀パラジウム(Ag/Pd) ← 標準 銀白金(Ag/Pt) ← 特注 金(Au) ← 特注
抵抗体	酸化ルテニウム(RuO <sub>2</sub> )
オーバーコートガラス	非結晶化ガラス(硼珪酸ガラス)

